

半導體先進封裝測試設備

種子師資培訓班

■ 課程簡介：

在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，培育人才，盼藉由先進封裝製程與設備技術種子師資培訓班，邀請對先進封裝製程與設備技術議題有研究的老師，與業界先進一同分享其研究與課程之規劃及授課經驗，期能有助於教師從創新培訓課程的設計及經驗，導入業界人才需求之課程，以提升學生實務之教學品質。

課程大綱：

110年9月29日(三)		
時間	課程名稱及大綱	講師
09:30-12:30	1.封裝種類說明(BGA/LGA/WLCSP,and others) 與製程與故障分析實例探討	抱樸科技 丁博士
12:30-13:30	午餐	
13:30-16:30	2.封裝驗證流程分享	抱樸科技 丁博士
110年9月30日(四)		
時間	課程名稱及大綱	講師
09:30-12:30	3.Info, CoWoS 先進封裝製程與設備技術	抱樸科技 丁博士
12:30-13:30	休息	
13:30-16:30	4.什麼是 FAN outWLP 扇外型平板級封裝	抱樸科技 丁博士

※主辦單位得因不可抗拒因素，保留本培訓班內容及講師異動之權利。

【 開 課 資 訊 】

- 主辦單位：財團法人工業技術研究院
- 承辦單位：社團法人台灣電子設備協會
- 舉辦地點：線上課程
- 舉辦日期：110年9月29-30日(三四)09:30-16:30 (兩天共12小時)
- 課程費用：免費，限大專院校相關系所教師報名，不含教職員及學生。
- 報名方式：

1.請至 TEEIA 網頁，或掃 QR code 報名。

報名連結: <https://www.teeia.org.tw/zh-tw/Course/110090203/124>



- 2.請於報名後，提供教師證或名片影本 e-mail 至 vivi@teeia.org.tw，以利確認查核。
- 3.9月29-30日皆需出席，結業時將發給教師種子師資培育時數證明。

- 報名聯絡人：

TEL：02-27293933 ext.17 楊小姐, ext.22 鄭小姐

FAX：02-27293950

E-mail：vivi@teeia.org.tw、anne@teeia.org.tw

- 注意事項：

1. 完成線上報名後，系統會發送『報名通知信』至您的 email 信箱，如未收到請來電確認。
2. 為尊重講師之智慧財產權益，恕無法提供課程講義電子檔。
3. 為配合講師時間或臨時突發事件，主辦單位有調整日期或更換講師之權利。
4. 因課前教材、講義及午餐之準備，若您不克前來，請於開課三日前告知，以利行政作業進行並共同愛護資源。

- 主辦單位保留報名資格之最後審核權利。